

Strategy Idea



글로벌 투자전략 - 신흥국

Analyst 최설화

02. 6454-4883

xuehua.cui@meritz.co.kr

중국 AI 반도체 국산화의 길

- ✓ 딥시크, 알리바바 등 중국 AI 반도체 생태계 내의 국산화 움직임 가속
- ✓ 최근 중국 정부의 反 엔비디아 움직임 강화, 국산대체 비율 요구 상승
- ✓ 중국 내 국산 AI 반도체 점유율 상승 전망, 관련 ETF와 대표기업 투자 기회 지속될 것

중국 AI 반도체의 딥시크 모멘트

중국 내 AI 생태계 구축 움직임
강화

올해 중국 AI 산업은 여러 측면에서 중요한 변곡점들을 맞이하고 있다. 연초 DeepSeek(딥시크) R1 추론 모델의 발표로 미·중 LLM 모델 성능 차이가 크게 축소되었는데, 최근에는 중국 내 AI 생태계 자립 움직임이 예상보다 빠르게 강화되고 있다.

1. 딥시크의 V3.1 모델과 FP8 데이터 처리 기술

딥시크, 자국산 반도체에
최적화 모델 출시

딥시크는 8월에 공개한 V3.1 최신 모델에서 UE8M0 FP8 스케일을 공식 채택한다고 밝히면서 이 모델은 '차세대 국산 칩과도 호환된다'는 메시지를 내놓았다.

FP8 형식은 엔비디아가 주도하는 글로벌 기업들이 사용하는 AI 추론의 국제 산업 표준이다. 메모리 절감하고 성능 효율 최적화의 장점을 갖고 있다.

다만 딥시크의 UE8M0 FP8은 변형된 포맷으로 중국 국산 칩이 당장 글로벌 FP8 표준을 완벽하게 지원하지 못하는 한계를 메우는 전략으로 볼 수 있다. 현지 보도에서는 딥시크의 R2 차기 모델이 화웨이의 AI 칩인 어센드(Ascend)를 탑재하고 성능 테스트를 하고 있다고 전해지고 있다. 딥시크는 단순 LLM 모델을 넘어 중국 AI 산업의 자립 과정에서 소프트웨어로 로컬 하드웨어의 단점을 보완하며 산업의 핵심 파트너로 생태계에 기여하려는 전략적 움직임을 엿볼 수 있다<표 1>.

표1 DeepSeek의 기술 개발 과정 정리

일자	모델	설명
24년 12월	V3 모델 출시	오픈소스 LLM 모델
25년 1월	R1 추론 모델 출시	추론 특화 모델
25년 5월	R1 업데이트	기존 모델 대비 전반 성능 향상(추론력, 수학/코딩 성능, 정확성)
25년 8월	V3.1 출시	FP8 등 신기술 도입, 오픈소스 고성능

자료: DeepSeek, 메리츠증권 리서치센터

2. 알리바바 시칩: 자체 개발 & 자국 생산

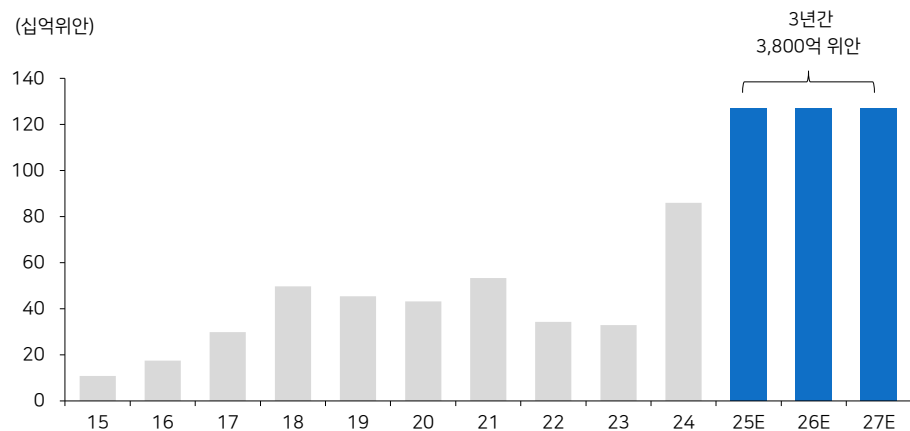
알리바바 자체 칩 개발 및 자국 생산 추진

월스트리트저널(WSJ)에서는 최근 알리바바가 차세대 AI 칩 개발 중이며, 이미 테스트 단계에 있다고 보도했다. 또한 생산은 TSMC 가 아닌 로컬 파운드리를 통해 생산할 계획이라고 전했다. 이에 대해 알리바바 측은 아직 공식적인 답변을 내놓지 않았지만, 지난 8월 29일에 있는 1Q26 실적 컨퍼런스에서 CEO가 AI 칩 조달에 플랜 B를 갖고 있다고 밝혀, 반도체 국산화 전략에 대한 기대가 커졌다.

이에 주가가 19% 급등했는데 시장에서 주목한 점은 2 가지라고 생각된다. 즉 기존에는 엔비디아 칩 없이 동사의 AI 사업 확장이 쉽지 않을 것으로 예상했지만, 1) 자체 개발한 칩이 이미 테스트 과정에 있어 곧 출시될 가능성이 높고, 2) 생산도 미국 제재를 받는 TSMC 가 아닌 중국 기업으로 돌리면서 AI 사업 차질 우려가 크게 해소될 수 있다.

올해 2 분기 알리바바의 클라우드 사업 매출액은 전년동기대비 26% 증가하는 양호한 실적을 기록했다. 2 분기 CAPEX 투자액도 386 억 위안으로 시장 예상치인 300 억 위안을 27% 상회했다. 회사는 앞으로 3 년간 AI 분야에 3,800 억 위안의 투자를 계획대로 집행할 것임을 재차 강조했다. 해당 투자가 로컬 AI 생태계에 투입된다면 전체 로컬 생태계의 강한 수요로 연결될 수 있다.

그림1 알리바바의 '25~'27년간 총 3,800억 위안을 투입 약속



자료: 알리바바, 메리츠증권 리서치센터

국산화의 길: 정부의 외압과 대체 방안

중국 기업들의 빠른 국산대체 흐름은 미국의 기술 제재에 맞서기 위한 중국 정부의 국산대체 정책이 중요한 촉매제로 작용했다.

중국 정부의 반 엔비디아 움직임 강화

7월 31일 중국 정책당국은 엔비디아의 H20 칩에 백도어 위험이 있다고 지적하면서 중국 기업들의 신중한 구매를 요구했다. 비록 중국에서 H20 칩 판매가 금지된 것은 아니지만 사실상 많은 기업들의 사용에 제한을 둔 조치인 셈이다. 이에 엔비디아가 B30A 칩으로 대체방안을 추진 중이지만, 미중 양국 정책당국의 심의를 거쳐야 하는 상황으로 여전히 불확실성이 높다. 엔비디아가 최근 3분기 중국 사업 매출 가이던스를 제시하지 못한 원인이 아닐까 싶다.

국산대체 비율 요구도 상승

한편 중국 정부는 국산 AI 반도체의 구매를 유도하고 있다. 대표적인 조치는 자국 공공 데이터센터들의 컴퓨팅 칩의 절반 이상을 중국 업체로부터 공급 받도록 요청하는 것이다. 특히 베이징과 상하이시는 '27년까지 데이터센터의 컴퓨팅과 스토리지 칩 국산 채택률 70%를 넘기는 목표를 제시하고 있다.

로컬에서도 적극적인 엔비디아 대체 방안 출시

따라서 중국 내 다양한 엔비디아 칩 대체 방안들이 나타나고 있다. 대표적인 몇 가지 솔루션을 정리하면 다음과 같다.

1. 화웨이

1. 화웨이의 어센드(Ascend): 현재 중국에서 엔비디아 칩을 대체할 수 있는 가장 강력한 대체 방안이다. 화웨이는 어센드 시리즈를 통해 데이터센터용 GPU 대안을 제시하고 있다. 최신 모델인 어센드 910C는 엔비디아 A100보다 2.5배 높은 성능을 나타내고 있다. H100에 비해서는 60~80%의 성능을 보이나, 에너지 효율과 비용 면에서 경쟁력을 갖춘다고 설명한다. 미국 제재로 TSMC 생산이 차단되며 SMIC의 7나노 공정을 활용하고 있다.

화웨이는 단일 AI칩 성능의 단점을 극복하기 위해 어센드 칩 클러스터화를 통해 엔비디아 시스템을 능가하는 결과를 시도한다. 대표적인 제품은 <그림 2>의 올해 세계인공지능대회에서 선보인 Atlas 900 A3 SuperPoD (일명 CloudMatrix 384 AI 슈퍼클러스터)이다.

384개의 어센드 910c NPU를 버스 구조로 연결하여 클러스터 내 컴퓨팅, 저장 장치, 메모리 간의 통신 병목을 해소하여 마치 하나의 대형 컴퓨터처럼 작동하도록 시스템 수준에서 최적화했다. 단점은 매우 많은 전력을 소비하는 것이나, 엔비디아의 GB200 NVL72보다 성능이 66~67% 더 높은 것으로 나타났다. 즉 화웨이는 개별 칩의 성능 한계를 시스템 통합 기술로 극복하는 노력을 강구 중이다.

그림2 화웨이의 CloudMatrix 384 AI 슈퍼클러스터: 클러스터화를 통해 성능 제고



자료: 상해인공지능대회(WAIC), 메리츠증권 리서치센터

2. 캄브리콘

2. 캄브리콘의 MLU 370/590: 화웨이 다음으로 두번째 대체 방안이다. 캄브리콘은 초기에 추론 칩에서 시작했지만, MLU370 시리즈 통해 클라우드 AI 학습 시장에 본격적으로 진출하기 시작했다. MLU590은 엔비디아의 A100 대체급으로 내놓은 제품이며 A100 성능의 약 80%에 달하는 것으로 평가되고 있다. 내년에는 590의 상위 버전인 MLU690 라인업까지 발표하며 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장을 본격 겨냥하고 있다.

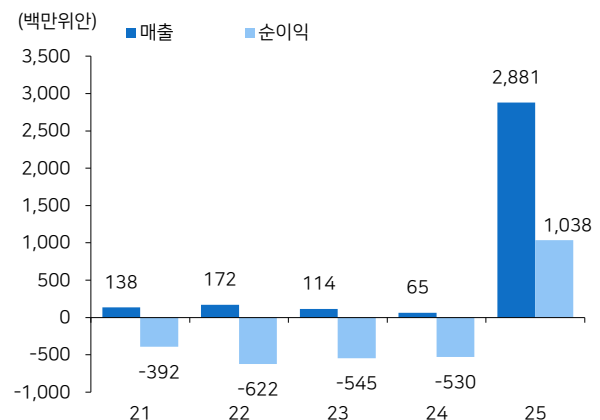
더 중요한 것은 국산대체 성과가 실적으로 반영되고 있다는 점이다. 상반기 중국 내 대형 AI 모델 수요와 국산칩 수요 정책 덕분에 매출액은 전년동기간의 44배로 늘었고, 순이익은 처음으로 흑자 전환했다(그림 4). 이에는 MLU370 제품의 이익 기여도가 높은 것으로 판단되며, 앞으로 MLU 590과 690 제품 양산과 함께 추가적인 실적 개선도 기대해볼 수 있다.

그림3 캄브리콘의 MLU370 시리즈 제품 설명

주요 제품	설명
MLU370-S4/S8	· 고밀도 클라우드 추론형 AI 가속카드 · 효율적인 전력소모 및 설치 공간 활용이 가능한 높은 집적 설계
MLU370-X4	· 클라우드 AI 수요를 겨냥한 추론과 학습 병합 설계 · 균형적이고 우수한 성능 제공
MLU370-X8	· 고성능 트레이닝에 최적화된, 듀얼 Siyuan 370칩으로 구성된 가속기 · MLU-Link 인터커넥트를 활용해 높은 확장성과 처리량을 지원

자료: Cambricon, 메리츠증권 리서치센터

그림4 올해 상반기 매출액 대폭 증가, 순이익 흑자전환



주: 매년 상반기 기준

자료: Wind, 메리츠증권 리서치센터

3. 바이두

3. 바이두의 Kunlun칩: 빅테크 중에서 추론 및 학습용 칩을 겨냥한 것은 바이두의 쿤룬(Kunlun) 칩이다. '21년부터 2세대 칩 양산을 시작했고 1세대 대비 성능이 2~3배 개선되었다. 연산 속도나 정밀도는 엔비디아의 A100 대비 약 40% 낮은 것으로 평가되고 있지만, 중국 내 자국산 칩 수요 정책 덕분에 활용도가 빠르게 늘어나고 있다. 바이두는 이를 자율주행, 클라우드 검색 등 서비스에 실제 적용하고 있다. 또한 화웨이처럼 바이두도 쿤룬2를 기반으로 만들어진 P800칩 3만개를 클러스터화 함으로써 전체 시스템의 성능을 개선하고 있다.

4. 스타트업들

4. AI칩 스타트업: 화웨이, 캠브리콘, 빅테크 외, 다양한 AI칩 스타트업들이 빠르게 발전하고 있다. Biren Tech, Moore Threads, Muxi 등 기업들이 대표적이다. 이 중에서 가장 강력한 칩 성능을 보인 것은 Biren의 BR100이다.

Biren은 2019년에 상하이에 설립된 팹리스 반도체 스타트업이며, SenseTime, Qualcomm, Huawei 출신 인사들이 포함되어 있었다. BR100은 첫번째 범용 GPU 제품으로 AI 데이터센터 컴퓨팅을 겨냥한 고성능 칩이다. 회사에 따르면 BR100은 딥러닝 워크로드에서 A100보다 약 2.6배 빠른 처리 속도를 보인다.

그러나 문제는 BR100 공정이 TSMC 7나노에 기반했는데, 미국의 기술 규제 영향으로 TSMC가 생산을 중단했다. 이에 현재 생산량은 제한적인데, 이는 Biren 뿐만 아니라 기타 스타트업들이 공동으로 겪고 있는 문제이다.

정리하면, 현재 중국에서 많은 기업들이 엔비디아 A100 성능과 비슷한 칩을 만들려고 노력 중이다<표 2>. 그러나 단일 칩의 성능이 아직 엔비디아의 고성능 칩을 대체할 수 있는 수준이 아니다 보니, ▲ 클러스터화를 통한 시스템 성능 개선과 ▲ 딥시크 등 소프트웨어와 하드웨어와의 통합을 통한 전략적 솔루션을 시도하고 있는 것으로 판단된다. 무엇보다 성능이 약하더라도 정책당국이 적극적인 사용을 추진하고 있어 중국 내 국산 대체 속도가 빠르게 이루어질 가능성이 높다.

표2 중국 내 주요 엔비디아 AI칩 대체 방안 정리

지표	엔비디아	화웨이	Cambricon		BIREN	BAIDU
	A100	ASCEND 910C	MLU370	MLU590	BR100	KUNLUN P800
INT8 (TOPS)	624	400-500	약 256	미공개(설계 사양)	500+(주장)	256
FP16 (TFLOPS)	약 19.5	18~20(추정)	약 32	~80(보도치)	16~18	미공개
공정	TSMC 7nm	로컬 생산(7nm)	TSMC 7nm	TSMC 7nm	TSMC (생산 불가)	7nm, 소규모 양산
메모리	HBM2e	HBM2e	LPDDR4X	HBM2e	HBM2e	HBM/GDDR6
S/W 생태계	CUDA	CANN+MindSpore	NeuWare	NeuWare	BIRENSUPA	Paddle
용도	대규모 학습 및 추론	대규모 학습 및 추론	추론, 경량 학습용	HPC/AI 학습용	-	추론 및 학습용
비고	공급	정부 프로젝트의 우선 선정 대상	A100 대비 열세	A100의 80% 수준	-	CUDA 호환성 추구 주로 내부 사용

자료: DeepSeek, 메리츠증권 리서치센터

‘26년 중국 파운드리 생산능력 3배 확대

‘26년 로컬 생산능력 3배 확대

파이낸셜 타임스의 보도에 따르면 올해 말부터 화웨이를 위한 전용 AI 파운드리 공장이 가동을 시작할 예정이고, 내년에는 두 곳이 추가 가동될 것이라고 전했다. 이에 따라 화웨이를 위한 전체 생산능력이 SMIC가 보유한 동종 생산라인의 총합을 넘어설 전망이다. 아직 새로운 파운드리 주인은 누구인지에 대해 밝혀지지 않았고, 화웨이도 신규 공장의 설립에 대해 부인하고 있다.

한편 SMIC는 2026년에 7nm 생산능력을 현재의 2배 수준으로 확대할 계획이다. 현재 SMIC의 7nm 생산능력은 화웨이가 대부분 차지하고 있는데, 연말부터 화웨이 전용 파운드리가 가동된다면 SMIC의 생산 라인은 캄브리콘, 바이렌 등 중국의 다른 AI 칩 기업들에 배분될 수 있다. 이는 기타 AI 칩 기업들이 직면했던 생산능력 병목 현상 완화에 긍정적이다.

여기에 중국의 대표 메모리 기업인 CXMT도 SK 하이닉스, 마이크론, 삼성 등이 장악한 고대역폭메모리(HBM) 시장에 도전하고 있으며 내년 HBM3 출시를 목표로 하고 있는 것으로 현지 언론이 보도했다.

관건은 수출이다. 아직 SMIC의 7nm, 5nm 공정 수출에 대한 국내외 시각이 많이 엇갈리고 있다. 그러나 과거에도 그랬듯이 중국은 정부가 보조금 등 형식으로 높은 생산 비용을 부담 해주기 때문에 낮은 수출이라도 꾸준히 국내 생산을 늘리면서 국산화 진척을 가속화할 것이다.

표3 중국의 주요 파운드리 기업 현황

	기업명	중문명	상장코드	시총(조원)	주요 기술 노드	주요 특징 및 강점	주요 적용 분야
1	SMIC	中芯国际	688981	108	7nm, 14nm, 28nm 주력	중국 1위, 전세계 4위 파운드리로 가장 공정이 앞선 중국 본토 기업	스마트폰, AP, CPU, IoT, 자동차, CIS 등
2	화홍	华虹半导体	688347	19	55/65nm, 90nm, 130nm	Specialty Process의 강장 eNVM(플래시 메모리 내장) 공정 세계 선두	MCU, IoT, RFID, Envrm, Power Discrete
3	Nexchip	合肥晶合	688249	9	40/55nm	디스플레이 드라이버 IC에 특화, 중국 3대 파운드리 중 하나로 생산능력 빠르게 확대	Display Driver IC, CIS, MCU 주요 고객사는 BOE, TCL 등
4	CR Micro	华润微	688396	13	90nm 이상, 200nm 기반	전력 반도체 및 아날로그 중심	자동차, 가전
5	United Nova	芯联集成-U	688469	8	-	전력 소자 (IGBT/MOSFET), MEMS, RF, 아날로그 IC, MCU 중심	자동차, 신재생에너지, IoT
6	HLMC	华力微电子	비상장	-	14~28nm	SMIC 자회사격, 로직 및 메모리 병행	차량용 반도체

주: 8월 29일 종가 기준. 위안화 적용환율=193원/위안
자료: Wind, 메리츠증권 리서치센터

중국 AI 국산 자립 가시화, 대표기업과 ETF에 주목

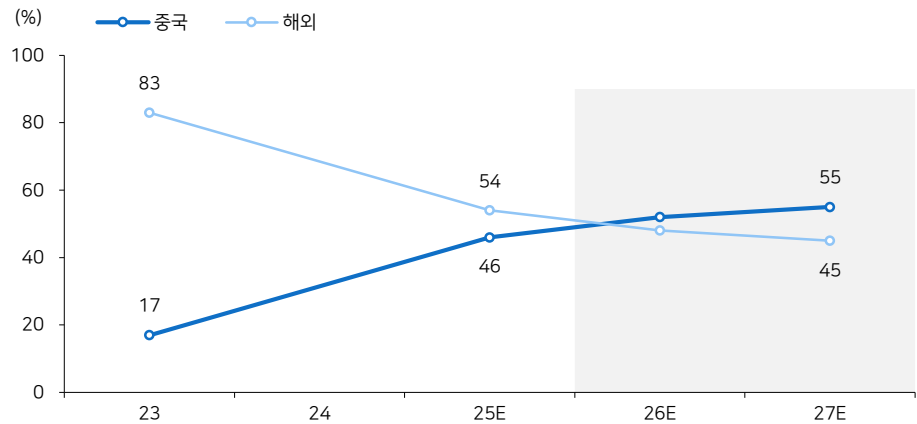
중국 내 AI칩 점유율 상승 전망

결론적으로 중국의 AI 반도체 산업은 미국의 기술 규제로 해외 칩 조달이 어려워졌고, 그 공백을 메우기 위해 부득이하게 국산화가 가속화된 사례이다. 정책당국도 AI 생태계의 자립을 촉진하기 위해 공영 데이터센터, 금융권, 국영기업의 국산칩 우선 채택 정책을 추진하며 국산 대체를 가속화하는 촉매제 역할을 담당했다.

중국 기업들도 국산화를 위해 다양한 기술 성과를 거두었다. 연초 딥시크의 모델 효율화 아키텍처에 이어, 화웨이, 캄브리콘, 알리바바, 바이옌 등 여러 기업들이 자체 생태계 구축에서 실질적인 성과를 거두며, 해외와의 격차를 좁혀갔다.

이런 환경 변화로 투자은행 번스타인(Bernstein)은 중국 AI 칩 시장의 국산화 비중을 '23년의 17%에서 올해 46%, '27년에는 55%까지 상승할 것으로 전망했다. (그림 5). 휴대폰, 전기차에 이어 유일하게 해외와 격차가 컸던 반도체 산업에서 중국 기업의 점유율 상승 추세가 가시권에 진입하게 된 것이다.

그림5 '27년이면 중국 내 국산화 비중은 55%로 절반 이상을 초과할 전망



자료: 메리츠증권 리서치센터

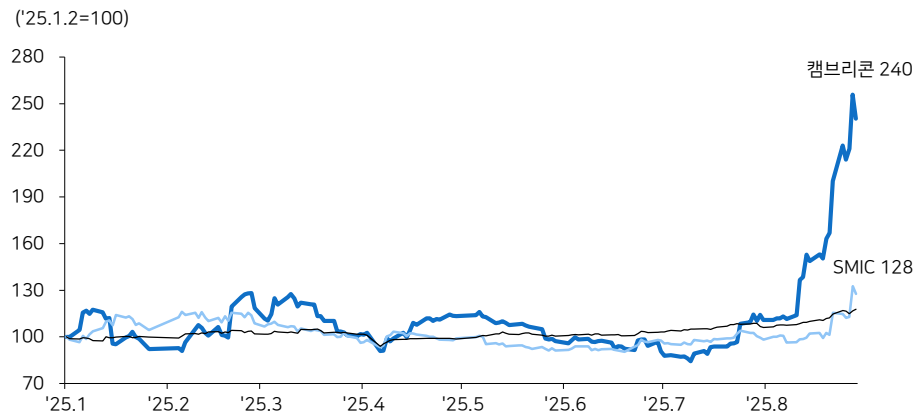
8월 중국 주식시장에서 AI 반도체 국산화 가속 기대감에 관련 기업 주가가 급등했다. 미니 엔비디아라고 불리는 캄브리콘의 주가는 8월 한달간 110% 상승하며 시가총액도 100조원을 돌파했다. 또한 국내 최대 파운드리인 SMIC의 본토 주가도 월간 28% 상승했으며, 9/1일 알리바바 홍콩 주가는 자체 AI 칩 개발 호재에 17% 급등했다.

핵심은 이런 대표 기업들의 주가 상승이 단기 테마라기보다는 사실상 정부의 정책 방향, 기술 내재화 성과 및 실적 개선이라는 펀더멘털의 변화가 동반된 변화라는 점이다. 정부 정책이 수요 부양의 마중물 역할을 해주고, 기업들이 기술 발전을 통해 중국 내 점유율을 확대해 나아가면서 기업 이익 증가와 ROE 동반 상승이라는 선순환 흐름을 기대할 수 있다.

국산 생태계 수혜 투자 지속 예상

따라서 중장기 투자 관점에서 중국 AI 반도체의 우상향 사이클은 이제 시작에 불과하다고 생각한다. 단기적으로는 보면 8월 급등 및 전승절 이벤트 소멸로 9월에 해당 섹터에 차익실현 매물이 출회할 수 있지만, 이는 오히려 중장기 관점에서 매수의 기회로 활용할 필요가 있다는 생각이다. 관련하여 <표 4>는 중국 AI 생태계 자립의 대표 기업을 담은 한국에 설정된 ETF이고, 대표 기업은 <표 5>에 정리해 두었으니 투자에 참고하기 바란다.

그림6 중국산 AI 반도체 대표 기업: 연초대비 캄브리콘 140%, SMIC 28% 상승



주: 본토 상장 코드 기준이며 증가는 8/29일 기준
자료: Wind, 메리츠증권 리서치센터

표4 한국에 설정된 차이나 AI 반도체 국산화 관련 ETF

코드	ETF명	운용사	상장일	기초지수	AUM (억원)	기간수익률(%)			총보수율 (%)
						1M	3M	YTD	
0047A0	TIGER 차이나테크TOP10	미래에셋자산운용	2025.5.13	미래에셋 China Tech Top10 Index	1,290	10	21	16	-
396520	TIGER 차이나반도체	미래에셋자산운용	2021.8.6	FactSet 차이나반도체지수	529	20	33	13	0.59
0065G0	KODEX 차이나테크TOP10	삼성자산운용	2025.6.17	향생 China Tech Top 10 Select Index	742	0	7	7	0.46
428510	KODEX 차이나AI테크	삼성자산운용	2022.05.13	-	225	10	29	17	0.67

주: 8월 29일 종가 기준
자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

표5 중국의 AI 반도체 국산화 관련 수혜 기업

구분	기업명	코드	시가총액	26년 P/E	26년 EPS 증가율	기업소개 및 수혜 포인트
			(조원)	(x)	(% YoY)	
칩	캠브리콘	688256.SH	117	175.4	92.8	중국 최초 AI칩 상장사. GPU 국산 대체 수요 증가
	Hygon	688041.SH	94	102.6	46.8	중국 내 CPU 제조 분야 선두기업, 국산 대체 수요 증가
생산	SMIC	688981.SH	111	64.3	41.1	중국 내 최대 파운드리 상장기업, 국내 생산 수요 증가
	화홍반도체	688347.SH	19	63.0	140.9	스페셜티 파운드리 기업, HLMC와 통합시너지 추진 보도
OSAT	JCET	600584.SH	14	9.7	6.3	중국 3대 OSAT 기업 중 하나, AI 가속기 및 후공정 수요 증가
	통푸미전자	002156.SZ	10	38.3	29.5	중국 3대 OSAT 기업 중 하나, AI 가속기 및 후공정 수요 증가
	화텐테크	002185.SZ	7	36.8	30.8	중국 3대 OSAT 기업 중 하나, AI 가속기 및 후공정 수요 증가
	남조정보	000977.SZ	20	27.9	31.7	중국 1위, 글로벌 3위 서버 기업, 국산화에 따른 수요 증가 기대
서버	Sugon	603019.SH	26	40.8	27.3	중국의 슈퍼컴퓨터 전문기업, 국산화에 따른 수요 증가 기대
	레노버	0992.HK	24	11.1	14.8	글로벌 IT기업으로 국내외 인프라 솔루션 매출 증가 기대
	알리바바	9988.HK	454	13.2	24.5	자체 LLM 모델, 클라우드 및 ai 칩 개발 → 선순환 생태계
	바이두	9888.HK	44	11.0	11.0	자체 LLM 모델, 클라우드 사업 및 ai 칩 개발 → 선순환 생태계
클라우드	텐센트	700.HK	964	17.7	13.5	AI 생태계 구축에 따른 중국 AI 응용산업 가속화 수혜
	Innolight	300308.SZ	87	33.1	44.7	글로벌 Hyperscaler 공급 경험, 중국 최대 광모듈 업체 중 하나
CPO/ 광통신	TFC 옵티컬	300394.SZ	33	55.6	37.6	AI칩 고속 인터커넥터 구성요소 공급 회사로 AI 클러스터의 데이터 전송 효율성 개선, 전력 소모량 감소

주: 시가총액, P/E는 9월 1일 종가 기준. 위안화 적용 환율 = 193원/위안
 자료: Wind, Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

- 본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.